

檔 號：

保存年限：

國立清華大學 函

地址：新竹市光復路2段101號

承辦人：鄒紫歆

電 話：03-5742930

傳 真：03-5722204

電子郵件：tstzou@ie.nthu.edu.tw



受文者：景文科技大學

發文日期：中華民國105年08月08日

發文字號：清工工字第1059004117號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：敬邀貴校學生參加「第三屆半導體大數據分析競賽」，請查照轉知。

說明：

- 一、本校「科技部IC產業同盟」產業技術聯盟合作計畫暨深耕工業基礎技術專案計畫與台灣積體電路製造股份有限公司共同舉辦「第三屆半導體大數據分析競賽」，本競賽不限就讀系所，凡大學（含）以上的在校生皆可參賽，歡迎跨領域跨校系組隊報名來挑戰並參加相關培訓課程，符合資格者將發給參賽或晉級等相關證明。
- 二、半導體大數據分析競賽由台灣積體電路製造股份有限公司提供高額獎金：第一名獎金30萬元整，第二名獎金10萬元整，第三名獎金5萬元整以及學員每人獎狀和指導老師之獎狀等，並舉辦正式頒獎典禮以資獎勵。
- 三、科技部「IC產業同盟」計畫並整合台灣積體電路製造股份有限公司、SAS、Amazon Web Services (AWS)、1111人力銀行、清華-台積電卓越製造中心、中華卓越經營決策學會、哈佛商業評論繁體中文版、亦思科技、工研院巨資中心、前程文化等主協辦單位，在競賽期間為所有報名的學生授課培訓，增強他們在半導體產業領域、資料挖礦及大數據分析軟硬體應用等方面的專業技能，並提供實際案例和參賽經驗分享，為培養產業大數據分析人才、深耕工業基

電子彙 2016/8/8



礎技術而共同努力。

四、報名時間即日起至105年9月25日止，詳細競賽、相關培訓課程及就業資訊，請隨時參考「科技部IC產業同盟」計畫網站、「半導體大數據分析競賽」專頁及「1111人力銀行大數據專區」：


(一) <http://step.unison.org.tw/bigdata>

(二) <https://www.facebook.com/groups/BDD.UNISON/>

(三) <http://www.1111.com.tw/zone/bigdata/>

正本：公私立大專校院

副本：簡禎富教授

本  負責規定授權單位主管決行